

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《2023年度業績快報公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二四年二月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

孫國棟

葉峻

周利民

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩 太平紳士

葉龍蜚

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-005

华虹半导体有限公司 2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,623,187.40	1,678,571.80	-3.30
营业利润	117,791.99	336,957.28	-65.04
利润总额	117,754.41	334,055.21	-64.75
归属于母公司所有者的净利润	193,623.04	300,861.26	-35.64
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	161,402.82	257,034.11	-37.21
基本每股收益（元）	1.31	2.31	-43.29
加权平均净资产收益率	6.49%	16.30%	减少 9.81 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	7,622,635.11	4,787,661.43	59.21
归属于母公司的所有者权益	4,335,425.24	1,984,479.37	118.47
股本	3,389,604.21	1,293,956.17	161.96
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	29.33	15.23	92.58

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

3、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司的所有者权益/发行在外普通股的加权平均数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况及财务状况

报告期内，公司实现营业收入 1,623,187.40 万元，同比下降 3.30%；营业利润 117,791.99 万元，同比下降 65.04%；利润总额 117,754.41 万元，同比下降 64.75%；归属于母公司所有者的净利润 193,623.04 万元，同比下降 35.64%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 161,402.82 万元，同比下降 37.21%。报告期末，公司总资产 7,622,635.11 万元，同比增长 59.21%；归属于母公司的所有者权益 4,335,425.24 万元，同比增长 118.47%。

2、影响经营业绩的主要因素

根据第三方调研机构 IBS 数据显示，受到终端消费市场持续萎靡影响，全球半导体市场二零二三年下滑约 10%，晶圆代工市场亦遭遇挑战，预测下滑约 10%~15%。半导体行业处于面对需求疲软、库存高企、价格压力、代工厂产能利用率较低等多重压力阶段，芯片供过于求推高库存并导致芯片价格持续走低。

受此影响，公司平均销售价格和产能利用率出现下降，再加上产能扩充，新产品研发加速，折旧费用和研发费用上升，使得公司营业利润、利润总额和归属母公司所有者的净利润都出现了一定幅度的下降。

（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

本报告期内营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期下降幅度超过 30% 以上，主要是由于平均销售价格下降和产能利用率下降及研发费用上升所致。

本报告期末总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初增长，主要由于公司本年度于科创板发行股份募集资金到位、华虹制造（无锡）项目少数股东实缴出资，及华虹无锡一期增资扩产 2.95 万片/月等项目本报告期投入增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2023 年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日